

Manufacturing



Automatic electroless Ni-Pd-Au ceramic plating equipment

セラミック基板用 無電解 Ni-Pd-Au めっき

～用途～

無電解 Ni-Au 厚付けめっき製品の代替皮膜として各種 LED 照明用途のセラミック基板へ採用されております。無電解めっきでのボンディング、又、無電解 Ni-Au 厚付けめっきの VE をご検討の場合は是非ともご検討下さい。

～生産能力～

◎対応製品サイズ

サイズ 130×200mm 約 3,000 枚/Day

サイズ 130×300mm 約 2,100 枚/Day

◎対応めっき仕様

無電解 Ni めっき 2.00～8.00 μ m

無電解 Pd めっき 0.05～0.40 μ m

無電解 Au めっき 0.10～0.30 μ m

◆Ag ペースト、Cu ペーストの両方に対応しております。

◇無電解 Ni-Pd-Au めっき浴は汚染に非常に弱く、量産前に溶出テスト等の実施をお勧めしております。